

<日本特許・実用新案明細書収録セット>

ホームページ公開中! <http://www.itdc-patent.com>

*最新の特許情報が満載!

枚葉式エッチング装置の構造

[公開編]平成5年~平成14年(10年間) 100点

全文PDF CD-ROM版(抄録版付) ￥30,000-
 全文紙収録 B5製本版 ￥30,000-
 (CD-ROM版・B5製本版 一括購入 ￥45,000-)

既刊関連セットのご案内

No.	公開特許	既刊関連セットのご案内	年次	点数	価格
No.9210	公開特許	透明導電膜形成用金属材料	平.11-12	66点	¥21,900
No.9212	"	透明導電膜のエッチング方法と浴の組成	平.11-12	56点	¥20,000
No.9213	"	ハードディスク研磨用組成物	平.10-12	61点	¥21,800
No.9214	"	ハードディスク用基板のメッキ方法	平.10-12	59点	¥20,900
No.9215	"	ガラスのウェット・エッチング方法	平.10-12	59点	¥20,700
No.9218	"	ガラス基板の補修・再生方法	平.5-12	73点	¥25,400
No.8639	"	液晶ガラスの保護膜形成法と組成物	平.5-10	95点	¥40,000
No.8632	"	透明導電膜のエッチング方法と浴の組成	平.5-10	59点	¥40,000
No.8701(B)	"	透明導電膜形成用金属材料	平.9-10	62点	¥21,000
No. "(A)	"	"	平.7-8	56点	¥19,000
No.8868	"	半導体ウェハのメッキ方法と装置	平.5-11	103点	¥35,000
No.8963	"	フォトリソスト剥離剤の組成	平.5-11	76点	¥27,700
No.9010	"	透明導電膜形成用塗料の組成	平.9-11	55点	¥24,400
No.9064	"	溶射用金属材料と溶射方法	平.8-12	105点	¥40,000
No.8856	"	温純水乾燥方法と装置	平.5-11	118点	¥40,000
No.8812	"	電解剥離方法と浴の組成	平.5-11	105点	¥40,000
No.8631	"	ステンレス用酸洗剤の組成	平.5-10	73点	¥40,000
No.8494	"	ハードディスク研磨用組成物	平.5-9	61点	¥23,500
No.8497	"	ハードディスク用基板のメッキ方法	平.5-9	66点	¥27,800
No.8508	"	磁気ディスク用ガラス基板の製造方法	平.7-9	53点	¥21,700
No.8496	"	ガラスへのメッキ処理方法	平.5-9	60点	¥23,700

*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、EメールまたはFAX・郵便にてお送りください。

(メール宛先: kokusai@itdc-patent.com お電話でも承ります)

[CD-ROM版はPDFファイルにしおりリンク機能、B5製本版はB5サイズ・目次製本済みです。]

2~3日中に請求書同封の上お送り致します。]

お 申 込 書

会社名	ご注文内容
	ニュースガイド No. , CD-ROM版・B5製本版・一括購入
所属部署	題 名
	合計 ¥
担当者名	E-mail
	() FAX ()
住所 〒	

枚葉式エッチング装置の構造

[公開編] 平成5年～平成14年(10年間) 100点

CD-ROM版 ¥30,000

B5製本版 ¥30,000

(CD-ROM版・B5製本版 一括購入 ¥45,000)

1 エッチング方法及びその装置	株式会社東芝	37 液晶用ガラス基板の熱処理装置	日立化成テクノプラント株式会社
2 半導体装置の製造方法	日本電気株式会社	38 液晶用ガラス基板の熱処理装置	日立化成テクノプラント株式会社
3 枚葉式ドライエッチング装置	日電アネルバ株式会社	39 リードフレームのエッチング加工装置	大日本印刷株式会社
4 枚葉式プラズマエッチング装置	九州日本電気株式会社	40 プラズマエッチング設備におけるエンドポイントの検出装置	三星電子株式会社
5 超音波処理槽と枚葉式基板処理装置	富士通株式会社	41 液晶用ガラス基板の熱処理装置	日立化成テクノプラント株式会社
6 枚葉式エッチャーによるシリコン窒化膜のエッチング方法	日本電気株式会社	42 ドライエッチング装置およびドライエッチング方法	松下電子工業株式会社
7 枚葉式プラズマエッチング装置	九州日本電気株式会社	43 多層A配線のエッチング方法	株式会社日立製作所
8 枚葉式ドライエッチング装置およびその装置を用いた枚葉式ドライエッチング方法	三菱電機株式会社	44 配線材のエッチング方法	株式会社日立製作所
9 枚葉式エッチング装置	松下電器産業株式会社	45 液晶表示素子の製造装置	株式会社東芝
10 ドライエッチング装置	セイコーエプソン株式会社	46 枚葉回転処理方法及びその装置	東京エレクトロン株式会社
11 半導体製造装置	三菱電機株式会社	47 真空処理装置	株式会社芝浦製作所
12 ドライエッチング装置	山口日本電気株式会社	48 枚葉式ウェットエッチング装置	株式会社東芝
13 液晶パネルの製造方法	松下電器産業株式会社	49 半導体のドライエッチング方法	株式会社デンソー
14 エッチング装置	新日本製鐵株式会社	50 ウェーハの枚葉アルカリエッチング装置	株式会社スーパーシリコン研究所
15 枚葉型エピタキシャル成長装置	株式会社東芝	51 ウェーハ面取り部の枚葉処理装置	株式会社スーパーシリコン研究所
16 半導体ウェーハ洗浄装置	株式会社日立製作所	52 表示素子形成用角型基板の製法	株式会社アドバンスト・ディスプレイ
17 誘電体分離基板の製造装置	三菱マテリアルシリコン株式会社	53 スパッタ膜、液晶素子及びこれらの製造方法	キャノン株式会社
18 枚葉式ドライエッチング装置及びそれを用いた半導体装置の製造方法	山口日本電気株式会社	54 スパッタ膜、液晶素子及びこれらの製造方法	キャノン株式会社
19 半導体装置製造工場のウエハ搬送システム	住友金属工業株式会社	55 スパッタ膜、液晶素子及びこれらの製造方法	キャノン株式会社
20 ドライエッチング方法	ソニー株式会社	56 エッチング方法および装置	株式会社テラテック
21 透明基板の洗浄方法	松下電器産業株式会社	57 プラズマ処理方法	ソニー株式会社
22 半導体装置の製造方法	日本電気株式会社	58 液晶表示装置の製造方法	日本電気株式会社
23 基板の搬送システム及び基板の搬送方法	東京エレクトロン株式会社	59 枚葉式ウエハ用化学気相堆積/エッチングプロセスチャンバのための石英ピンリフト	アブライド マテリアルズ インコーポレイテッド
24 液晶ガラス基板の枚葉管理用ナンバリング方法	株式会社東芝	60 基板洗浄装置	鹿児島日本電気株式会社
25 液晶表示素子の製造方法	オプトレックス株式会社	61 ウェットエッチング装置	株式会社ケミトロニクス
26 薄膜形成方法	株式会社東芝	62 液晶用ガラス基板の熱処理装置	日立化成工業株式会社
27 薄膜トランジスタの製造方法	株式会社東芝	63 液晶表示素子の製造方法	広島オプト株式会社
28 半導体装置の製造方法およびプラズマエッチング装置	富士通株式会社	64 ガラス基板熱処理装置	キャノン株式会社
29 水平搬送型ウェット処理方法	凸版印刷株式会社	65 枚葉式表面加工装置	株式会社デンソー
30 ドライエッチングの終点検出方法および装置	ソニー株式会社	66 半導体シリコンウエーハの製造方法	信越半導体株式会社
31 半導体装置の製造方法およびその製造装置	株式会社東芝	67 枚葉式ウエーハエッチング装置及びウエーハエッチング方法	信越半導体株式会社
32 エアナイフ乾燥方法	日本電気株式会社	68 ウエハ処理方法及びウエハ処理装置	ソニー株式会社
33 枚葉式スピネッチング方法	日曹エンジニアリング株式会社	69 ドライエッチング装置及びこれを用いた液晶表示装置の製造方法	株式会社アドバンスト・ディスプレイ
34 処理装置	東京エレクトロン株式会社	70 枚葉式エピタキシャル成長装置及びそのクリーニング方法	三菱マテリアルシリコン株式会社
35 ドライエッチング装置およびドライエッチング方法	シャープ株式会社	71 枚葉式真空処理方法及び装置	株式会社日立製作所
36 四隅が支持されて持ち上げられた基板のたわみ軽減方法および枚葉式基板処理装置	シャープ株式会社	72 液晶表示装置の製造方法	三菱電機株式会社

以下28点省略